

มอสเฟต (MOSFET)

ทรานซิสเตอร์ในยุคที่สองที่เรียกว่า "ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า"
 (Field effect transistors , FET) และได้มีการพัฒนาต่อไปเป็น FET
 ในยุคที่สอง เรียกว่า "มอสเฟต" (MOSFET) ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่
 นำไปสู่การสร้างวงจรรวมหรือไอซี (IC) ทำให้เกิดการปฏิวัติทาง
 อิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การสร้างวงจรรวมขนาดใหญ่หรือ VLSI ซึ่งเป็น
 หัวใจสำคัญของไมโครโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

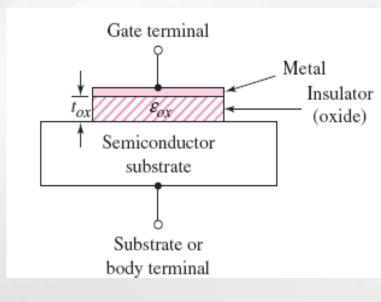
- มอสเฟต (MOSFET)

 "มอสเฟต" หรือ Metal oxide semiconductor field effect transistor เป็นทรานซิสเตอร์ที่ สร้างขึ้นมาในช่วง ทศวรรษ 1970s ซึ่งเป็นทรานซิสเตอร์ในยุคที่สองหลังจากที่ได้มีการสร้าง ทรานซิสเตอร์ใบโพล่า (BJT) มาก่อนหน้านี้ แล้ว MOSFET เป็นทรานซิสเตอร์ที่มีคุณสมบัติ ดีกว่าทรานซิสเตอร์ BJT ที่สามารถสร้างได้ง่ายกว่า BJT มาก และยังสามารถลดขนาดให้เล็ก ลงได้ จึงทำให้สามารถสร้างเป็นวงจรรวมได้
- นอกจากนี้การสร้างวงจรโดยใช้ MOSFET ไม่จำเป็นต้องใช้ ตัวต้านทานหรือไดโอด ช่วยใน การไบอัสวงจร เหมือนกับทรานซิสเตอร์ BJT เนื่องจาก MOSFET สามารถทำงานได้โดยใช้ แรงดันไฟฟ้าในการไบอัส ซึ่งต่างจากทรานซิสเตอร์ BJT ที่ต้องใช้กระแส(การป้อนกระแส ซึ่ง จะทำให้เกิดกระแส I_B และ I_C ตามลำดับ)ทำให้วงจร MOSFET มีขนาดเล็กกว่าวงจรของ **BJT**
- ในการทำงานของมอสเฟส กระแสจะถูกควบคุมโดยการป้อนสนามไฟฟ้าเข้าที่บริเวณพื้นผิว ของสารกึ่งตัวนำทั้งสองฝั่ง ปรากฏการณ์นี้ที่เคยมามาใช้ในการมอดูเลตตัวเก็บประจุของสาร กึ่งตัวนำ หรือการควบคุมกระแสในสารกึ่งตัวนำ โดยในการที่ป้อนสนามไฟฟ้าตั้งฉากกับ พื้นผิวนี้จะถูกเรียกว่า field effect



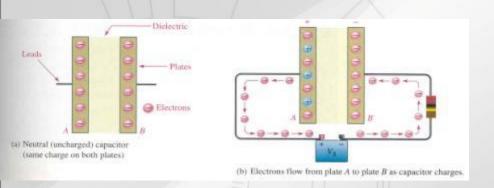
โครงสร้างพื้นฐานของตัวเก็บประจุมอส (MOS capacitor)

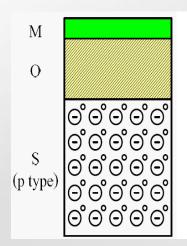
• หัวใจสำคัญของ MOSFET ก็คือการสร้างตัวเก็บ ประจุจากสารกึ่งตัวนำที่เป็นออกไซด์ของโลหะ (Metal oxide semiconductor capacitor) แสดง ดังรูป 5-1 โลหะที่กล่าวถึงนี้อาจเป็น อลูมิเนียม หรือสารบางอย่างที่มีความนำไฟฟ้าสูงเช่น polycrystalline silicon ก็ได้ โดย เป็นค่าเป็น ความหนาของออกไซด์โลหะ $oldsymbol{t}_{ox}$ และ \mathcal{E}_{ox} คือค่า ความซึมซาบได้ของออกไซด์ (oxide permittivity)

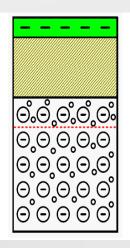


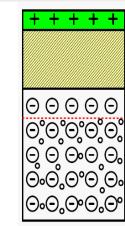
โครงสร้างของ MOS capacitor ซึ่งจำลองแบบมากจากการ ทำงานของตัวเก็บประจุ

• โครงสร้างทางฟิสิกส์ของมอส สามารถอธิบายอย่างง่ายได้ก็คือว่ามัน จะมีโครงสร้างคล้ายกับตัวเก็บประจุ (มีแผ่นตัวนำที่ขนานกันและมีฉนวน คั่นระหว่างตัวนำทั้งสอง)



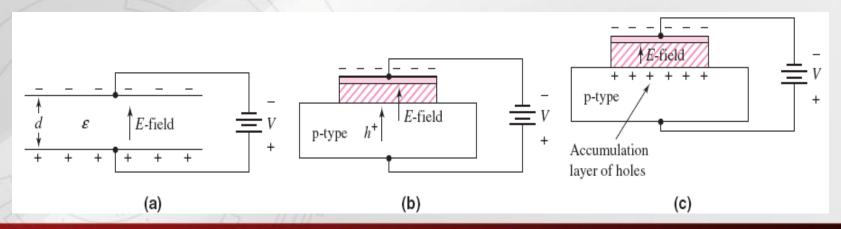




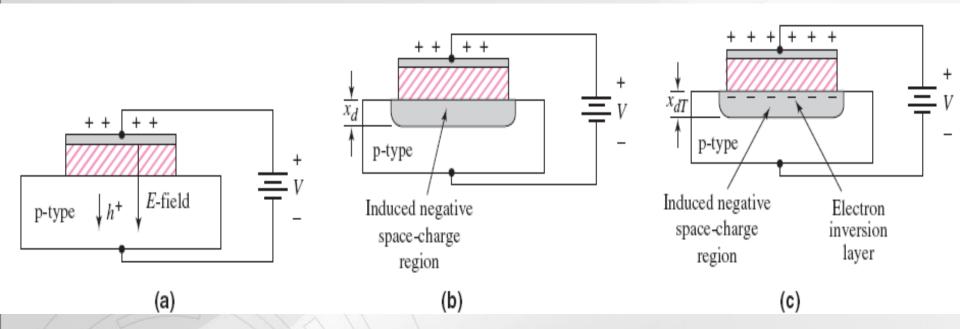


การเกิดสนามไฟฟ้าบนแผ่นตัวเก็บประจุแบบขนาน

• ฐานรองของสารกึ่งตัวนำ (semiconductor substrate) ซึ่งอาจจะเป็นสาร n หรือ p ก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง และจากรูปก็สามารถสร้างให้เป็นตัวเก็บประจุได้ ในรูปที่ 3 เป็นภาพการเกิดสนามไฟฟ้า (Electric field) ภายในตัวเก็บประจุ แบบแผ่นขนาน โดยให้แผ่นด้านบนได้รับแรงดันไฟลบเมื่อเทียบกับแผ่นด้านล่าง ได้รับแรงดันไฟบวก โดยตรงกลางระหว่างแผ่นทั้งสองเป็นฉนวน (Insulator ใน ที่นี้คือ Oxide นั่นเอง) ซึ่งการต่อแบบนี้ก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นระหว่าง แผ่นทั้งสอง



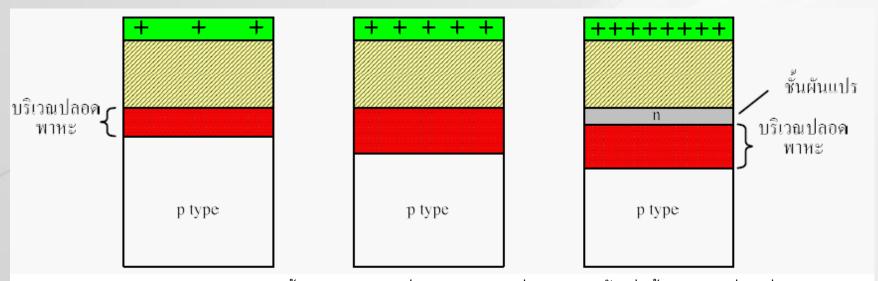
ผลของการใบอัสศักดาบวกที่ขั้วเกต และทิศทางของ สนามไฟฟ้า



• 3 (a) แสดงผลของการใบอัสศักดาบวกที่ขั้วเกต และทิศทางของ สนามไฟฟ้า (b) แสดงการเกิดย่านปลอดประจุ (space charge region) ในตัว MOS capacitor เมื่อได้รับแรงดันใบอัสบวกค่าหนึ่ง (c) แสดงการเกิด space

charge region และ electron inversion layer ในตัว MOS capacitor

บริเวณปลอดพาหะใต้ชั้นออกไซด์ก็จะเปลี่ยนเป็นสาร n เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนถึงจุดเริ่มเปลี่ยน

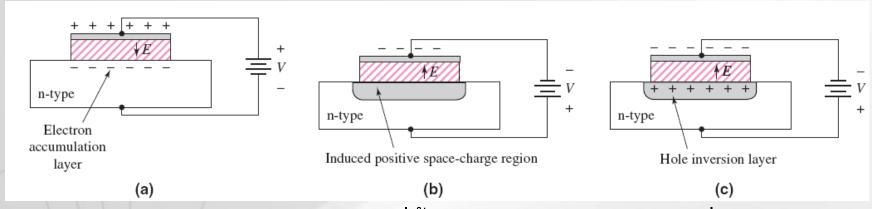


บริเวณปลอดพาหะใต้ชั้นออกไซด์ก็จะเปลี่ยนเป็นสาร $oldsymbol{n}$ เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนถึงจุดเริ่มเปลี่ยน

เมื่อเพิ่มแรงดันตกคร่อม MOS Capacitor มากขึ้น สนามไฟฟ้าที่คร่อมชั้น oxide จะแรงขึ้นทำให้โฮล ถูกผลักลงไปด้านล่างมากขึ้น ส่งผลให้บริเวณปลอดพาหะ ที่ใต้ชั้น oxide มีความหนามากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจนถึงจุดเริ่มเปลี่ยน (threshold) บริเวณปลอดพาหะใต้ชั้นออกไซด์ก็จะเปลี่ยนเป็นสาร n เรียกว่าชั้นผัน

แปล (inversion layer) แสดงดังรูป

โครงสร้างของ MOS capacitor ที่มีฐานรอง เป็นสารชนิด **n**



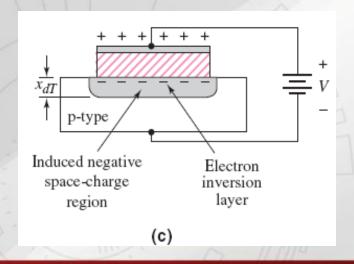
- (a) แสดงผลของการไบอัสศักดาบวกที่ขั้วเกต ของ MOS capacitor ที่ฐานรองเป็น สารชนิด n
- (b) แสดงการเกิดย่านปลอดประจุ (space charge region) ในตัว MOS capacitor เมื่อได้รับแรงดันไบอัสลบค่าหนึ่ง
- (c) แสดงการเกิด space charge region และ hole inversion layer ในตัว MOS capacitor

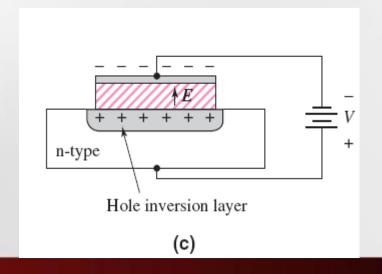


Electron vs. Hole inversion layer

โดยสรุปก็คือว่า Mos capacitor
โดยมีฐานรองเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดสาร P
แรงดังไฟฟ้าบวกจะต้องป้อนเข้าที่ขาเกท
เพื่อสร้าง electron inversion
layer

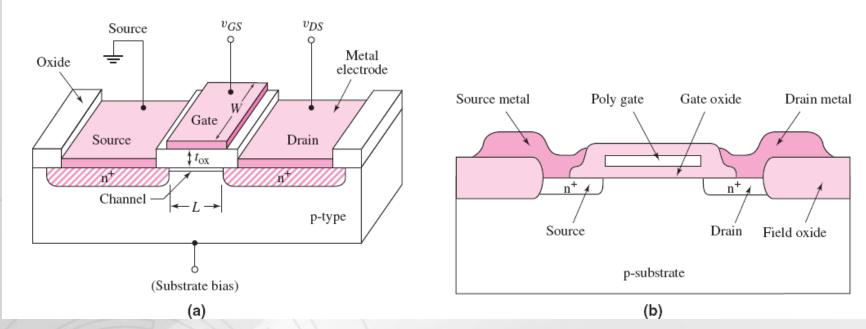
แต่ในทางกลับกัน Mos capacitor
โดยมีฐานรองเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดสาร n
แรงดังไฟฟ้าลบจะต้องป้อนเข้าที่ขาเกท
เพื่อสร้าง hole inversion layer





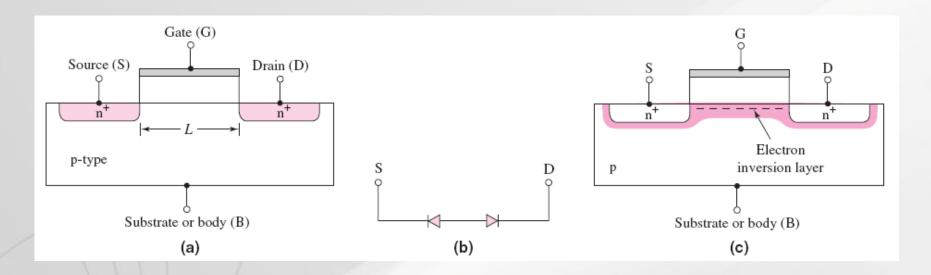


n-Channel Enhancement-Mode MOSFET



แผนผังโครงสร้างของ n-channel enhancement-mode MOSFET (b) n-channel MOSFET แสดงโลหะออกไซด์และ polysillicon gate

การทำงานของมอสเฟตทรานซิสเตอร์เบื้องต้น



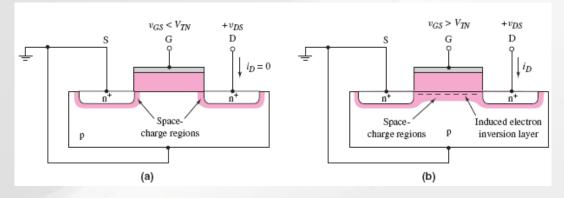
ภาพตัดขวงของ n-channel MOSFET ก่อนที่จะมีการสร้างชั้นผันแปร (inversion layer), (b) วงจรสมมูลย์ของ n-channel MOSFET ที่ประกอบไปด้วยไดโอดสองตัวต่อหันหลังชนกันระหว่างขาเกท กับขาเดรนเมื่อมอสเฟตหยุดทำงาน (cutoff) และ(c) ภาพตัดขวางหลังจาก ที่มีการป้องแรงดันไฟฟ้าให้กับมอสเฟตและมีการสร้างชั้นผันแปรขึ้น

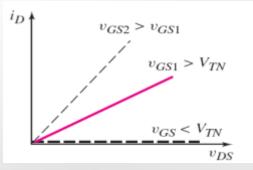


Ideal MOSFET Current-Voltage Characteristics—MOS

ในกรณีที่ V_{DS} มีค่าน้อยดังแสดง ในรูปที่ 9 เมื่อ V_{GS} < V_{TN} กระแส ที่ขาเดรนจะเป็นศูนย์ เมื่อ V_{GS} > V_{TN} แชนแนลของประจุผันแปรจะ ถูกสร้างขึ้นและกระแสที่ขาเดรน จะเพิ่มขึ้นโดย ด้วยค่าแรงดันที่ ขาเกทที่สูงมากกว่า ความ หนาแน่นของประจุผันแปรก็จะมี ้จำนวนมากขึ้นด้วย และกระแส เดรนก็จะมีจำนวนมากตามค่า แรงดัน V_{ns} ที่ป้อน

Device

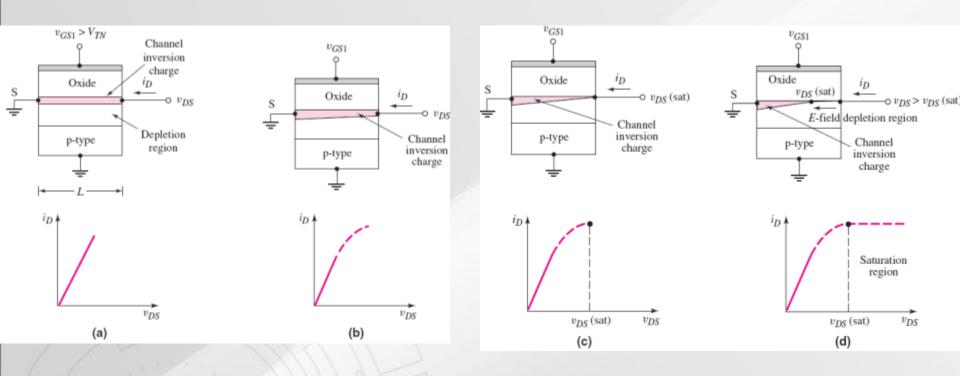




$$v_{GS}$$
 - $v_{DS}(sat) = V_{TN}$

$$v_{DS}(sat) = v_{GS} - V_{TN}$$

"ย่านอื่มตัว" (saturation region)



• กระแสเดรนจะมีค่าคงที่เมื่อ $v_{DS} > v_{DS} (sate)$ ย่านนี้ของคุณสมบัติระหว่าง i_D กับ v_{DS} เรียกว่า ย่านอิ่มตัว $(saturation\ region)$ แสดงดังรูป



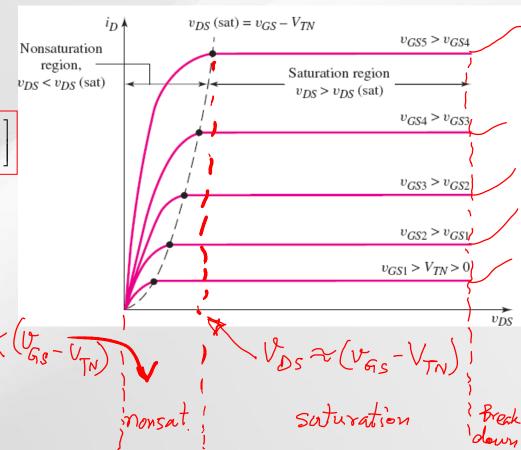
กราฟสำหรับ n-channel enhancement mode MOSFET

ในย่าน nonsaturation หรือ triode region

$$i_D = K_n \left[2(v_{GS} - v_{TN})v_{DS} - v_{DS}^{2} \right]$$

ในย่านอิ่มตัว คุณสมบัติระหว่าง กระแสและแรงดันเมื่อ $\mathbf{V}_{GS}>\mathbf{V}_{TN}$ ได้ถูกอธิบายโดยสมการดังนี้

$$i_D = K_n (v_{GS} - V_{TN})^2$$



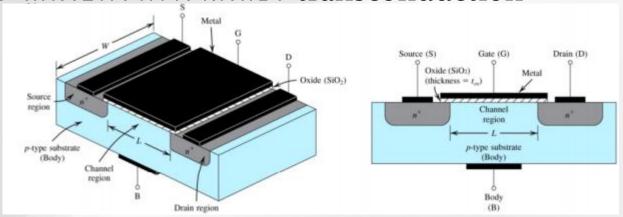


พารามิเตอร์ transconduction

• พารามิเตอร์ K_n จะถูกเรียกว่าพารามิเตอร์ transconduction

$$K_n = \frac{W \mu_n C_{ox}}{2L}$$

$$K_n = \frac{k_n'}{2} \cdot \frac{W}{L} \bigg|_{k_n' = \mu_n C_{ox}}$$

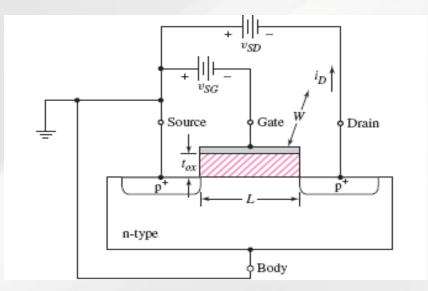


 k_n' คือ Process conduction parameter

โดย μ_n เป็นค่าคงที่เรียกว่า "ความคล่องตัวของอิเล็กตรอน " C_{ox} เป็นค่าความจุไฟฟ้าของสารออกไซด์ ต่อ 1 หน่วยพื้นที่ ซึ่งมาจากสมการเดิมคือ $C_{ox}=\varepsilon_{0x}/t_{ox}$ โดยที่ t_{ox} เป็นความหนาของออกไซด์ และ ε_{ox} ค่าความซาบซึมได้ของสนามไฟฟ้าหรือ ค่าความสามารถเก็บประจุซึ่งสำหรับสุญญากาศแล้ว $\varepsilon_0=(3.9)(8.85\times 10^{-14})$ ฟารัดต่อเมตร พารามิเตอร์ μ_n นี้คือความคล่องตัวของอิเล็กตรอนในชั้นผัน แปร ส่วนค่าของ W และ L คือความกว้างและความยาวของแซนแนลตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 6(a)

รูปตัดขวางของ p-channel enhancementmode MOSFET

ตรวจสอบจุดอื่มตัว



เมื่อมอสเฟตทำงานในย่าน nonsaturation

มอสเฟตทำงานในย่าน saturation

$$\int_{\partial V} \frac{1}{3} W = 097217070 YOUNDUNGA$$

$$\dot{L}_D = K_P \left(v_{sc} + V_{TP} \right)^2$$

Rywin p- channel MOSFET, NO YNORTWON 249202010 1279 1977 VsD > VsD(sat) = VsG+VTP

สรุปการทำงานของ MOSFET

Table 3.1 Summary of the MOSFET current–voltage relationships

NMOS

Nonsaturation region ($v_{DS} < v_{DS}(sat)$)

$$i_D = K_n[2(v_{GS} - V_{TN})v_{DS} - v_{DS}^2]$$

Saturation region $(v_{DS} > v_{DS}(sat))$

$$i_D = K_n (v_{GS} - V_{TN})^2$$

Transition point

$$v_{DS}(sat) = v_{GS} - V_{TN}$$

Enhancement mode

$$V_{TN} > 0$$

Depletion mode

$$V_{TN} < 0$$

PMOS

Nonsaturation region
$$(v_{SD} < v_{SD}(sat))$$

$$i_D = K_p[2(v_{SG} + V_{TP})v_{SD} - v_{SD}^2]$$

Saturation region
$$(v_{SD} > v_{SD}(sat))$$

$$i_D = K_p(v_{SG} + V_{TP})^2$$

Transition point

$$v_{SD}(\text{sat}) = v_{SG} + V_{TP}$$

Enhancement mode

$$V_{TP} < 0$$

Depletion mode

$$V_{TP} > 0$$

การเกิด Early Effect และ Early voltage ของ MOSFET

• สำหรับทรานซิสเตอร์ MOSFET ก็เช่นเดียวกัน มีการเกิด Early effect ที่ย่านอิ่มตัวเช่นกัน ทำให้กระแสเดรน i_D มีค่า ขึ้นอยู่กับแรงดัน \mathbf{v}_{DS}

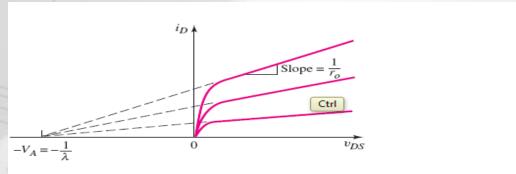
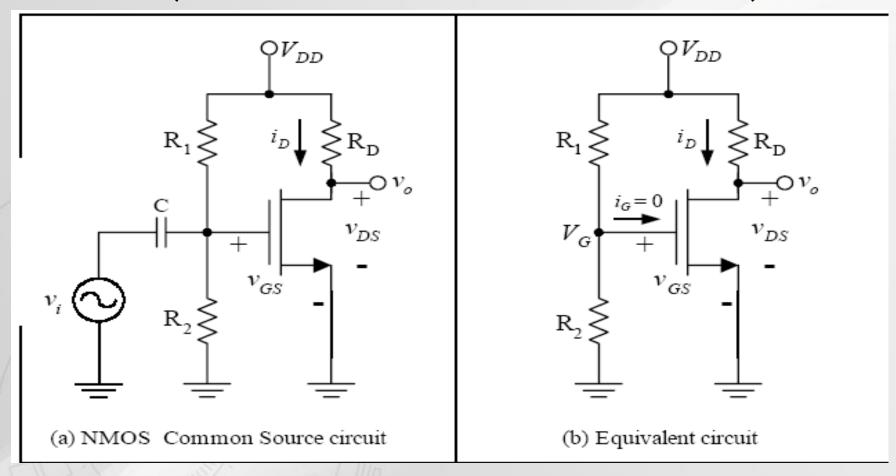


Figure 3.20 Family of i_D versus v_{DS} curves showing the effect of channel leng modulation producing a finite output resistance



$$i_D = K_n \left[\left(v_{GS} - V_{TN} \right)^2 \left(1 + \lambda v_{DS} \right) \right]$$

วงจรไบอัสไฟตรงของ MOSFET (MOSFET DC Circuits)



การวิเคราะห์วงจรไฟตรงของ MOSFET

• ในการวิเคราะห์วงจรไฟตรงของ MOSFET เนื่องจากที่ขั้ว gate ของ MOSFET ไม่ว่าจะเป็น NMOS หรือ PMOS จะมีชั้น ซิลิกอนไดออกไซด์ขวางอยู่ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวน ไม่นำไฟฟ้า ดังนั้น กระแสที่ขั้วเกต

(i_G) ของ MOSFET จึงมีค่าน้อยมากจนประมาณให้เป็นศูนย์ใด้ นั่นคือ $i_G=0$

สามารถใช้ได้ทั้ง emhamcememt mode และ depletio